**2022北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会**

**专题论坛意向回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基 本 信 息** | **公司全称** | 中文 |  | | |
| 英文 |  | | |
| **单位地址** |  | | | |
| **联系人** |  | | **移动电话** |  |
| **邮箱** |  | | | |
| **演 讲 信 息** | **拟报名分论坛** | □装备 □材料 □零部件 □智能厂务 □碳中和 □产学研  □其他（请注明： ） | | | |
| **演讲嘉宾姓名** |  | | | |
| **移动电话** |  | | **职位** |  |
| **邮箱** |  | | | |
| **演讲题目**（拟） |  | | | |
| **演讲摘要**  （不少于300字） |  | | | |